



产品公告

Edgetek™ 3D/LDS 解决方案

Edgetek™ 3D/LDS解决方案是帮助客户在模塑部件表面构建3D电路的先进技术——加工步骤更少,交付周期更短,生产成本更低。全新的Edgetek材料解决方案可广泛应用于一系列关键行业,包括5G基站、医疗设备、消费性电子产品等。

Edgetek 3D/LDS解决方案可通过PC、LCP、PPS制造,并根据客户的具体需求进行定制。此材料解决方案具有高设计灵活性、多功能集成、尺寸小型化和轻量化等特点,可以满足苛刻的制造要求,同时不影响生产效率和成本。

3D/LDS Edgetek配方可以让高端电子元件制造商缩小机械和电气系统组件,即使是在高温制造过程中,如表面贴装工艺(SMT),都可达到减小终端产品尺寸的目的,该配方可广泛应用于电子、汽车和5G行业及相关基础设施等行业。这项技术也能支持未来应用,以提高5G建设的通信质量。

主要特性

- 设计灵活性高
- 集成各种功能
- 小型化、轻量化
- 降低初始零件成本和生产成本
- 简化过程
- 缩短装配时间
- 在亚洲出售

市场与应用

Edgetek 3D/LDS解决方案可广泛应用于高要求的市场和应用,包括:

- 消费性电子产品
- 医疗
- 汽车
- 通信



www.avient.com



版权所有 © 2020埃万特公司。埃万特对本文件所含信息的准确性、在特定应用中的适用性、以及利用这些信息获得或可获得的结果不做任何陈述、保证和担保。部分信息来自使用小型设备进行的实验室测试结果,可能无法可靠指示使用大型设备获得的性能和属性。“典型”数值或未给出范围的数值不代表最低或最高属性;有关属性范围和最小/最大规格的信息,请咨询您的销售代表。加工条件可能会导致材料属性背离该文件所述的数值。埃万特对埃万特的产品或用于贵司工艺或者终端应用的信息的适用性不做任何担保或保证。您有责任进行全面的终端产品性能测试,以确定产品是否适用于您的应用工艺,同时您还需承担因使用这些资料和/或处理任何产品导致的任何风险和责任。对于这些资料或资料中所提及的产品,埃万特不做任何明示或暗示的保证,包括但不限于对特定用途的适销性和合适性的暗示保证。未经专利所有者许可,本数据表不得作为使用任何专利发明的许可、建议和诱因。